



イントロダクション

トップメッセージ

1 DNPとは

2 価値創造に向けた経営戦略

Section

3 価値の創出

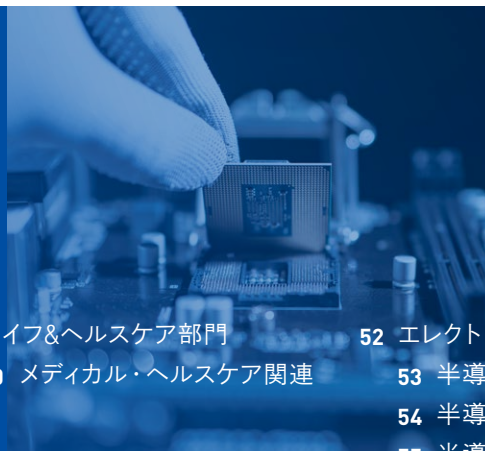
中長期の成長ストーリーの実現に向けて、
3つの事業セグメントにおける成長戦略と
具体的な取り組みをご説明します。

セグメント別事業戦略の全体像

- 44 持続的な成長を実現する事業戦略
- 45 注力事業による事業価値の創出

セグメント別事業戦略

- 46 スマートコミュニケーション部門
- 47 情報セキュア関連
- 48 フォトイメージング関連
- 49 ライフ&ヘルスケア部門
- 50 メディカル・ヘルスケア関連
- 52 エレクトロニクス部門
- 53 半導体関連
- 54 半導体関連（前工程）
- 55 半導体関連（後工程）



4 経営基盤の強化

5 コーポレート・ガバナンス

6 業績・会社情報

持続的な成長を実現する事業戦略

成長投資と構造改革による事業価値の向上

注力事業への成長投資と既存印刷関連事業の構造改革を着実に推進し、事業基盤の強化と収益力向上を実現していきます。

事業セグメント	スマートコミュニケーション部門		ライフ&ヘルスケア部門		エレクトロニクス部門																																																													
注力事業	情報セキュア関連 フォトイメージング関連		モビリティ&リビング関連 産業用高機能材関連		デジタルインターフェース関連 半導体関連（前工程）																																																													
成長 ポテンシャル 事業	コンテンツ・XRコミュニケーション関連 デジタルマーケティング関連		メディカル・ヘルスケア関連 無菌充填システム関連		半導体関連（後工程）																																																													
業績推移	■ 売上高(億円) ■ 営業利益(億円) ● 営業利益率(%) <table><thead><tr><th>年度</th><th>売上高(億円)</th><th>営業利益(億円)</th><th>営業利益率(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023実績</td><td>7,194</td><td>261</td><td>3.62</td></tr><tr><td>2024実績</td><td>7,155</td><td>346</td><td>4.83</td></tr><tr><td>2025実績</td><td>7,503</td><td>400</td><td>5.33</td></tr><tr><td>2026計画</td><td>7,420</td><td>430</td><td>5.79</td></tr></tbody></table>		年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)	2023実績	7,194	261	3.62	2024実績	7,155	346	4.83	2025実績	7,503	400	5.33	2026計画	7,420	430	5.79	■ 売上高(億円) ■ 営業利益(億円) ● 営業利益率(%) <table><thead><tr><th>年度</th><th>売上高(億円)</th><th>営業利益(億円)</th><th>営業利益率(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023実績</td><td>4,723</td><td>133</td><td>2.81</td></tr><tr><td>2024実績</td><td>4,960</td><td>237</td><td>4.77</td></tr><tr><td>2025実績</td><td>5,123</td><td>372</td><td>7.26</td></tr><tr><td>2026計画</td><td>5,160</td><td>390</td><td>7.55</td></tr></tbody></table>		年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)	2023実績	4,723	133	2.81	2024実績	4,960	237	4.77	2025実績	5,123	372	7.26	2026計画	5,160	390	7.55	■ 売上高(億円) ■ 営業利益(億円) ● 営業利益率(%) <table><thead><tr><th>年度</th><th>売上高(億円)</th><th>営業利益(億円)</th><th>営業利益率(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023実績</td><td>2,353</td><td>581</td><td>24.69</td></tr><tr><td>2024実績</td><td>2,477</td><td>573</td><td>23.13</td></tr><tr><td>2025実績</td><td>2,518</td><td>507</td><td>20.13</td></tr><tr><td>2026計画</td><td>2,740</td><td>540</td><td>19.70</td></tr></tbody></table>		年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)	2023実績	2,353	581	24.69	2024実績	2,477	573	23.13	2025実績	2,518	507	20.13	2026計画	2,740	540	19.70
年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)																																																															
2023実績	7,194	261	3.62																																																															
2024実績	7,155	346	4.83																																																															
2025実績	7,503	400	5.33																																																															
2026計画	7,420	430	5.79																																																															
年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)																																																															
2023実績	4,723	133	2.81																																																															
2024実績	4,960	237	4.77																																																															
2025実績	5,123	372	7.26																																																															
2026計画	5,160	390	7.55																																																															
年度	売上高(億円)	営業利益(億円)	営業利益率(%)																																																															
2023実績	2,353	581	24.69																																																															
2024実績	2,477	573	23.13																																																															
2025実績	2,518	507	20.13																																																															
2026計画	2,740	540	19.70																																																															
基本戦略	- 市場成長が見込まれるグローバルな有望市場などに積極投資 - グローバルでの生産体制・供給体制の強化 - 既存事業の強みを活かした価値創出		- M&Aによるシナジー創出と、市場・技術を起点とした事業開発 - 市場成長が見込まれる成長分野への積極投資（メディカル・ヘルスケア関連等） - 既存事業の構造改革と高付加価値化の推進		- 最先端半導体領域（EUVマスク、ナノインプリント等）での事業展開の加速 - 次世代半導体パッケージ分野における事業化の推進 - デジタルインターフェース関連事業の拡大																																																													
主な投資	情報セキュア関連 Rubicon SEZC社の子会社化（2025年度） AUSTRIACARD社のTOB実施（2026年度）		産業用高機能部材関連 レゾナック・パッケージング社の子会社化（2024年度） 福島県泉崎工場：太陽電池封止材生産能力増強（2025年度） モビリティ&リビング関連 HKホールディングス社（光金属工業所社）の子会社化（2024年度） メディカル・ヘルスケア関連 シミックCMO社の子会社化（2023年度） 協和ファーマケミカル社の株式取得（子会社化）に向けた株式譲渡契約締結（2026年7月）		デジタルインターフェース関連 福岡県黒崎工場：大型メタルマスク生産ライン新設（2023年度） 広島県三原西工場：光学フィルム新ライン増設（2025年度） 半導体関連 埼玉県上福岡工場：フォトマスク生産設備増強（2024年度・2025年度） DTファインエレクトロニクス社：フォトマスク生産ライン増設（2024年度・2025年度） DNPフォトマスクヨーロッパ社：フォトマスク生産設備増強（2024年度） 新光電気工業社の株式を保有するSPCへの出資（2024年度） 埼玉県久喜工場：ガラスコアパイロットライン新設（2025年度）																																																													
構造改革	紙メディア事業の合理化		低付加価値製品の見直しと拠点の再編																																																															
	2023年	商業印刷における製造拠点の最適化	2023年	包装関連事業 製造拠点閉鎖（中部エリア）																																																														
	2023年～	固定費の最適化	2024年～	固定費の最適化																																																														
	2025年	出版印刷部門の組織再編（DNP出版プロダクツ） 既存マーケティング関連の組織再編（DNPマーコムプロダクツ）	2025年	生活空間関連事業とモビリティ関連事業の事業再編（モビリティ&リビング事業部）																																																														
めざす社会 （社会的価値）	- あらゆるヒト・モノがつながる安全・安心で快適なスマート社会の実現 - 笑顔と安心があふれるコミュニケーション社会の実現		- 環境配慮製品・サービスによる循環型社会への貢献 - EVや再生可能エネルギーを支える部材提供を通じて脱炭素社会に貢献		- 情報との直観的なつながりを支える多様なデバイスの進化に貢献 - 次世代情報社会を支える高性能半導体の進化に貢献																																																													

注力事業による事業価値の創出

成長性・収益性に優れた事業領域へ経営資源を集中し、持続的な成長を加速する

DNPは、独自の印刷技術と「対話と協働」を通じて培ってきた強みを活かし、高いシェア・収益性・成長性を備えた注力事業へ積極的に成長投資を行っています。成長機会を的確に捉えながら事業の拡大を推進し、事業価値の向上を通じてDNPグループ全体の持続的な成長を実現していきます。

注力事業領域		収益性			成長性	市場シェア	P&I イノベーション			
		売上高 (億円)			ROE (2028年度計画)	市場CAGR (2025-30年度)	主力商材	高度化された印刷技術	対話と協働	今までにない新しい価値
		2022年度	2025年度	2028年度						
スマートコミュニケーション部門	情報セキュア関連 ■ ■	1,720	1,870	2,710	10%	約8% デジタルID・認証ソリューション 国内市場	ICカード 国内シェアNo.1 BPOサービス	・情報処理技術 ・微細加工技術 ・後加工技術	強み技術のグローバル展開 ・Rubicon SEZC社 グループ会社化 (2025) 海外の政府向けID認証サービス事業の取り込み ・AUSTRIACARD社のTOB実施 (2026)	◎ 市場の成長が見込まれるアフリカ・アジア・南米等の地域へ認証・ICカード事業を展開
	フォトイメージング関連 ■ ■	590	830	920		約5% グローバルフォト関連市場	写真プリント用昇華型熱転写記録材 世界シェアNo.1	・情報処理技術 ・精密塗工技術 ・後加工技術 ・企画・設計	グローバル市場での営業・企画・開発体制強化 ・米国Colorvision International社、ベルギー-Sharingbox社の全株式取得 (2020) ・インド現地法人営業開始 (2026)	◎ グローバルで、さまざまなコンテンツ・フォトプリントを楽しめる高付加価値のプリンターやメディアを開発 ◎ P&Iの技術を活用した新たなフォト体験の創出
ライフ＆ヘルスケア部門	モビリティ＆リビング関連 ■ ■ ■	130	160	200		約11% ハイエンドHMI市場	HMI製品、 外装加飾フィルム、 外装アルミパネル	・光学設計技術 ・精密塗工技術 ・後加工技術 ・企画・設計	モビリティ成形部品の開発・製造力強化 ・田村プラスチック製品社 グループ会社化 (2015) 加飾フィルムを活用したモビリティ成形部品の開発・製造 ・光金属工業所社 グループ会社化 (2025)	◎ 環境に配慮したモビリティ成形部品・塗装代替外装フィルムの開発 ◎ 車内のHMI (ヒューマンマシンインターフェース) 化に対応した光透過型フィルムの開発
	産業用高機能材関連 ■ ■	620	680	1,010		約12% 電動車市場 約15% ESS市場	リチウムイオン電池用 バッテリーパウチ 世界シェアNo.1 太陽電池関連製品	・精密塗工技術 ・後加工技術 ・材料開発技術 ・評価・解析	バッテリーパウチの製品領域拡大 ・レゾナック・パッケージング社グループ会社化 (2025) 両社合わせて800件以上の特許を保有 製品領域 (車載用途・IT用途・ESS用途) を拡大	◎ 車載・IT・蓄電池 (ESS) 全領域で強い技術と特許を持ち合わせたバッテリーパウチ外装材を提供 ◎ 次世代電池 (全固体電池など) にも対応可能な外装材を開発
エレクトロニクス部門	デジタルインターフェース関連 ■ ■ ■ ■	1,380	1,850	2,140		約5% デジタルインターフェース市場	ディスプレイ用光学フィルム 世界シェアNo.1※ 有機ELディスプレイ製造用メタルマスク 世界シェアNo.1	光学フィルム ・光学設計技術 ・材料開発技術 ・精密塗工技術 メタルマスク ・微細加工技術	自社生産ラインの拡張 ・広島県三原工場：最大2,500mm幅の光学フィルム製造が可能なコーティング装置を導入 ・福岡県黒崎工場：第8世代 (G8) サイズに対応したメタルマスクの生産ラインの稼働	◎ デバイスのニーズに応じた多様な機能を持つ光学フィルム (反射防止・防眩) の開発 ◎ 多様な情報端末への有機ELディスプレイ拡大のニーズを先取りした製品の開発
	半導体関連 ■ ■ ■ ■	660	670	1,100		約10% フォトマスク外販市場	半導体製造用フォトマスク 外販用フォトマスクで トップレベルのシェア	・光学設計技術 ・微細加工技術 ・精密塗工技術	最先端領域の事業化に向けたパートナーとの協働 ・半導体メーカー、装置メーカー、材料メーカー、研究機関他とのパートナーシップ ・新光電気工業社の株式取得を目的とする特別目的会社への出資 (2025) 半導体後工程での連携強化	◎ ナノインプリント、EUV (極端紫外線) など、最先端半導体製造への対応 ◎ 次世代半導体パッケージ向けTGV (ガラス貫通電極) ガラスコア基板を開発

■ 安全・安心かつ健康に心豊かに暮らせる社会 ■ 快適にコミュニケーションができる社会
■ 人が互いに尊重し合う社会 ■ 経済成長と地球環境が両立する社会

※ディスプレイ表面面の反射防止フィルムおよび防眩フィルムにおいて



積極的なグローバル投資を行うとともに、さらなる構造改革によって新しい価値の創出を加速

2023-2025年度 中期経営計画レビュー

2026-2028年度 中期経営計画

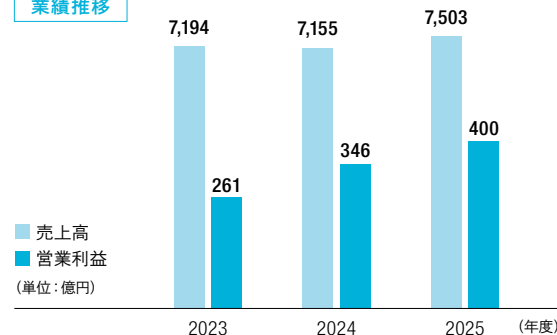
振り返り

- ・イメージングコミュニケーション関連等の事業が堅調に推移。
- ・出版関連事業や既存マーケティング関連事業の構造改革が寄与。

2025年度売上概要

- イメージングコミュニケーション関連：写真プリント用部材が新型プリンターの需要増等により好調だったほか、IDカード用インクリボンが堅調に推移し、前年を上回った。
- 情報セキュア関連：デュアルインターフェイスICカードが前年から減少したものの、BPOの大型案件などがあり、前年を上回った。
- コンテンツ・XRコミュニケーション関連：コンテンツ関連は国内外で人気の知的財産を活用したイベント等に注力したほか、XR関連は教育や行政分野のサービスを拡充。

業績推移



ポートフォリオの変革の考え方

成長性を確認し情報セキュア関連とフォトイメージング関連を基盤事業から注力事業へ、事業拡大の可能性を確認しデジタルマーケティング関連を成長ポテンシャル事業へ転換。

注力事業への積極投資

- 情報セキュア関連：市場成長が見込まれるグローバルな有望市場などに積極的に投資。グループに迎えたRubicon SEZC社とのシナジーなどによりグローバル展開を加速。
- フォトイメージング関連：昇華型熱転写プリンター・メディアの開発やメディア生産能力強化も含めたグローバルでの投資を推進。生産体制・供給体制を全世界で強化し、新興国市場の開拓も進めて、さらなる成長をめざす。

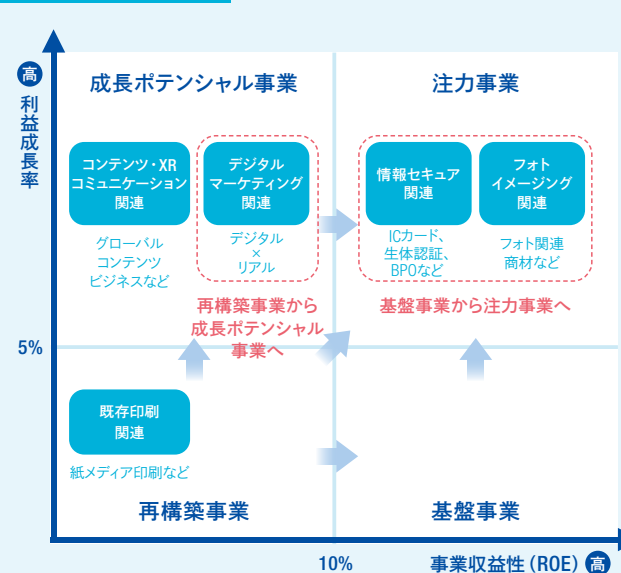
新たな価値の創出と構造改革

- 出版印刷関連：既存事業の収益性改善と新規事業拡大の両立により事業基盤を強化。
- マーケティング関連：リアルとデジタルの強みを活かし、事業プロセス全体で提供価値を最大化。

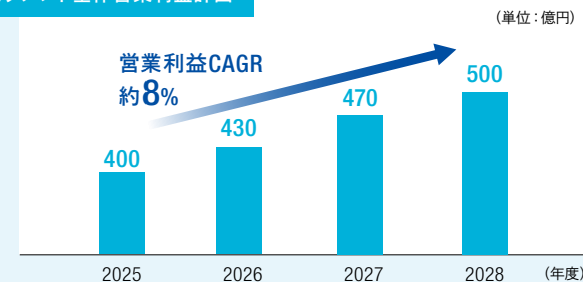
新たな注力事業の育成

- コンテンツ・XRコミュニケーション関連：各事業部門の強みを掛け合わせ、グローバル展開を見据えたコンテンツ（アニメ等の知的財産）ビジネスを展開。情報加工・変換技術とAI・XRを組み合わせ、社会課題の解決と新たな生活者体験に向けた価値を開発・提供。

ポートフォリオの変革



セグメント全体営業利益計画



成長戦略

モノからコトへ、グローバル展開

サイバーとフィジカルの両方の空間で「ヒト」「モノ」「情報」がつながるスマート社会において、「誰もが心地よく、意識することなく、安全・安心な生活ができる社会の実現」をめざす。

モノづくりを基盤とした
ビジネス拡大



● 製品・サービスの組み合わせによる
高付加価値サービスの開発・提供

サイバーとフィジカル両方のセキュリティリスクに対して、ICカードをはじめとする多様な製品・サービスを組み合わせ、認証や決済、教育などの領域で付加価値の高いソリューションを開発し普及させる。

● DNPグループ×パートナー企業の
協業による事業拡大

DNPが培った情報セキュア関連の強みと、世界の多様なパートナー（Cybertrust Japan、BroadBand Security等）の強みを掛け合わせ、認証・決済・サイバーセキュリティ領域の事業を拡大。

● グローバル事業の拡大

人口増加・デジタル化が進む新興国市場を今後の有望市場と捉え、その開拓に向けた投資を積極的に進めることで、情報セキュア事業のグローバル化を加速する。

今後成長が見込まれるアフリカ・アジアを中心に展開

社会インフラ領域で培った信頼と顧客基盤、「モノづくり×サービス×オペレーション」の統合型セキュリティモデル、海外パートナーとの連携による価値提供力を強みとして各種施策を展開。海外では、成長著しいアフリカ・アジアを中心にグループ全体で取り組みを強化していく。

● 公的ID領域で高付加価値なソリューションをグローバルに提供

2025年7月にグループに迎えたRubicon SEZC社や、2026年度にTOBを進めるAUSTRIACARD社とともに、本人登録からID証発行、認証まで、各国・地域のニーズに応じて公的ID領域の高付加価値なソリューションを開発・提供し、リーディングカンパニーをめざす。

3社のケイパビリティ

Rubicon SEZC

- 生体認証登録ソリューション
- 政府向けIDプロジェクトの豊富な実績
- 世界銀行プロジェクトへの参画実績

AUSTRIACARD

- 政府向けID・セキュリティソリューション
- 東欧・中東・アフリカ・北米での事業基盤
- カード発行・認証領域の豊富な実績

DNP

- セキュリティ印刷・認証技術
- プリンターおよび関連消耗品
- 日本・アジアでの事業基盤

公的ID領域における
提供機能



市場環境

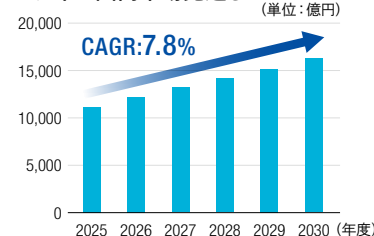
デジタルID普及を背景に、グローバルでの成長が期待できる

● 市場環境の変化

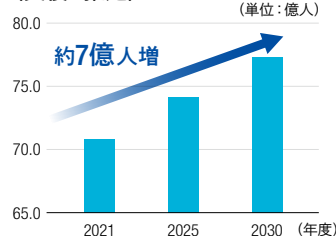
- デジタル技術の進化によるリスクの高度化、多様化
- 地政学リスクによる原材料調達の不安定化と価格高騰

● 成長ドライバー

- AIエージェントの普及、サイバーリスクの高度化に伴うガバナンス強化の高まり
- 社会構造の多様化・複雑化に伴う認証・セキュリティニーズ増
- 各国・地域における公的ID制度の普及とID利活用の拡大
- キャッシュレス決済の促進

デジタルID・認証ソリューション
ビジネス国内市場見通し

出典：総務省・経済産業省等の公表資料を基に当社独自の推定を加えて算出

世界の公的ID保有者数の推移
(実績・推定)

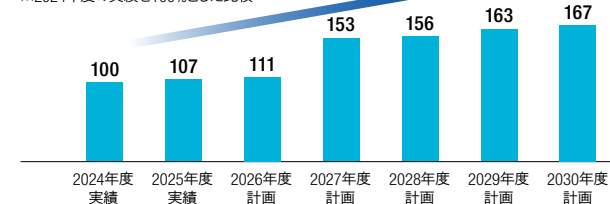
出典：World Bank「ID4D」、UN人口統計等を基に当社推計

業績推移と将来展望

国内外で高まる情報セキュア関連の需要拡大を背景に、成長戦略を着実に実行することで持続的な事業拡大を実現していく。

情報セキュア事業の売上計画

※2024年度の実績を100%とした比較



成長戦略

魅力ある商材開発／新興国での展開

本事業でめざす「あらゆる想いをカタチにし、笑顔と安心に満ちた世界をつくる。」を実現するため、高品質な写真プリントに加えて、さらなる魅力にあふれた商材を開発・提供していく。

新規市場の開拓と提供価値の拡大による持続的な成長



マーケットを反映した製品開発と最適地生産

- 日本・北米・欧州・アジアの製造・販売拠点や販売代理店を通じ、世界で100以上の国・地域にフォトプリンターとメディア（昇華型熱転写記録材）を提供。
- 世界各地の市場動向を反映した製品・サービスの開発力と最適地生産の実現力もDNPの強み。今後、成長が期待される東南アジア・南アジア・中国・アフリカに注力していく。

グローバル拠点とサプライチェーン



市場環境

フォト関連市場はグローバルで市場成長が期待

● フォト関連のグローバル市場規模

2024年：推定267億米ドル ▶ 2030年までCAGR 5.2%で成長*1

● DNPは2024年に8インチ両面フォトプリンター「DS820DX」を市場に投入

DS820DXでは、多様な用途のプリントが可能
▶ フォトブック、グリーティングカード、カレンダー等

● 北米市場に導入し、さらには他地域へ展開

● インドウェディングフォト市場 CAGR7.5%*2
インド国内観光消費の増加 CAGR7.4%*3

● 2026年3月 インド現地法人営業開始

DNP Imagingcomm India Pvt.Ltd.

- 昇華型フォトプリンター&メディアの販売
- インド市場に適した新しいビジネスモデルを展開

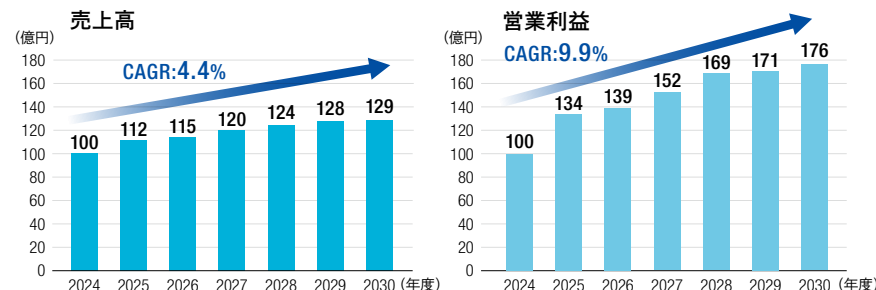
● フォトプリントシステム・フォトブースをウェディングイベントや観光地に展開



*1 Photo Printing & Merchandise/Global Information, 2025
*2 2024 Wedding Merchandise Market/Fortune Business Insights 2024
*3 Travel & Tourism Economic Impact 2024

業績推移と将来展望

- 新興国市場の開拓で販売エリアを拡大し成長を加速
- フォト関連市場において、プリンターやメディアの高付加価値品の伸長で利益を拡大



※2024年度の実績を100%とした比較

独自の技術を活かした機能性フィルムの開発・展開、グローバルでの事業拡大に向けた投資を積極化

2023-2025年度 中期経営計画レビュー

2026-2028年度 中期経営計画

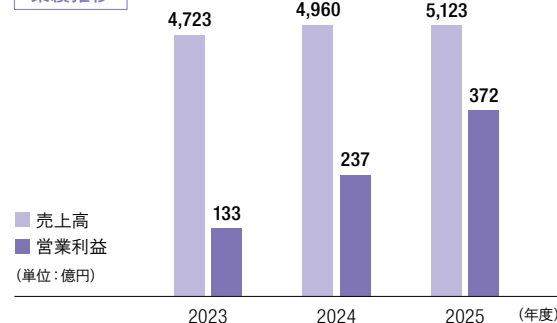
振り返り

- 包装関連は製造拠点再編やコストダウンにより収益体質が改善。
- 生活空間関連はモビリティ関連との組織統合による効率化と成長力強化を実施。

2025年度売上概要

- 産業用高機能材関連：車載向けバッテリーパウチが米国のEV向け補助金終了の影響を受けるも、太陽電池関連部材が増加。
- モビリティ関連：自動車向け加飾フィルムは内装用中心に堅調に推移したほか、DNP光金属と、ハイエンドHMI領域に事業拡大を推進。
- メディカル・ヘルスケア関連：医療用パッケージが好調に推移したことに加え、医薬品の原薬事業・製剤事業も堅調に推移し、前年を上回った。

業績推移



ポートフォリオの変革の考え方

事業拡大の可能性を確認し、無菌充填システム関連を新たに成長ポテンシャル事業として設定したほか、構造改革の成果によって収益性を確認し、包装関連を再構築事業から基盤事業へ転換した。

注力事業への積極投資

- モビリティ&リビング関連：DNP光金属（2025年2月にグループ会社化）とのシナジーでHMI (Human Machine Interface) 関連部材を拡大するとともに、グローバルも視野に事業を拡大。
- 産業用高機能材関連：バッテリーパウチの次世代電池への拡大、太陽電池関連の生産増、他産業用途への各種機能性フィルム関連製品の展開などで成長を加速。

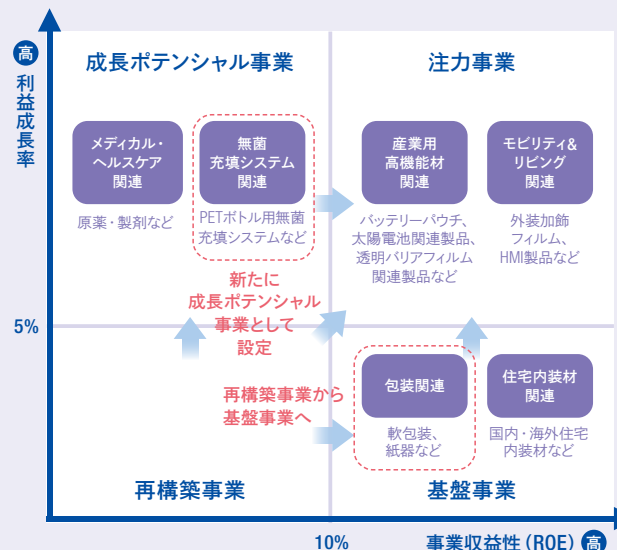
新たな価値の創出と構造改革

- 包装関連／生活空間関連：継続的に構造改革を行い、さらに強い収益体質を確立。
- 産業用高機能材関連／包装関連：グローバルを見据えた高付加価値フィルム関連製品を開発し、新たな価値を創出。

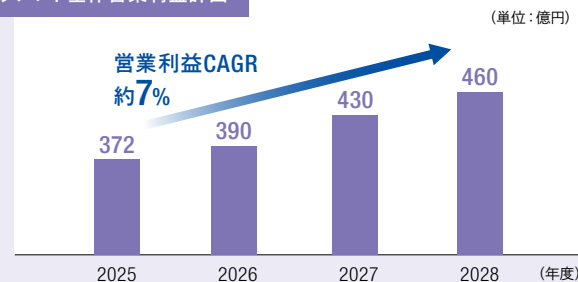
新たな注力事業の育成

- 包装関連：国内トップシェアの無菌充填システムについて、グローバル市場に領域を拡大。
- メディカル・ヘルスケア関連：シミックCMOや協和ファーマケミカルとの連携により原薬・製剤・包装の一貫したビジネスを展開。

ポートフォリオの変革



セグメント全体営業利益計画



成長戦略

製薬企業のバリューチェーンの
アウトソーシング領域を中心に事業の成長を図る

製薬企業のバリューチェーンにおけるアウトソーシング領域を中心として、自社の研究開発とパートナーとの連携強化によって事業を展開。高い品質を基盤に、医薬品の開発と安定供給を通じて社会に価値を提供し続ける。

4つの事業を基盤に、新領域への挑戦でさらなる拡大を加速

製剤事業

シミックCMOの高品質な製造力とDNPの技術力を融合し、高付加価値な製剤事業を展開

原薬事業

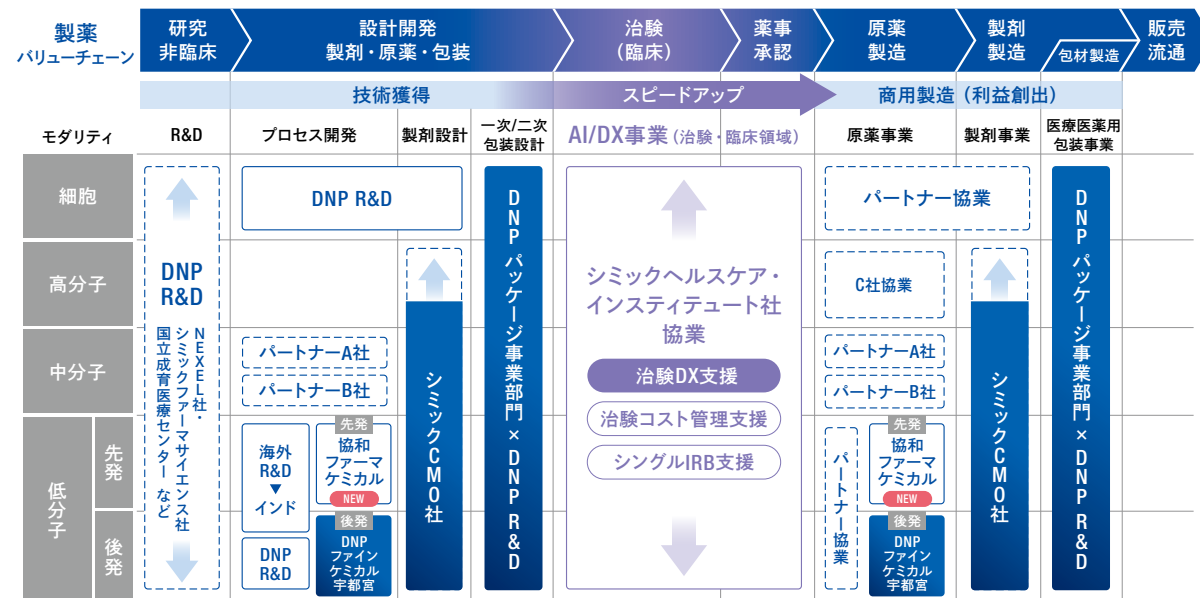
高品質な原薬の安定供給と革新的な製品開発

医療用パッケージ事業

食品・日用品等で培った包装パッケージ技術を活用

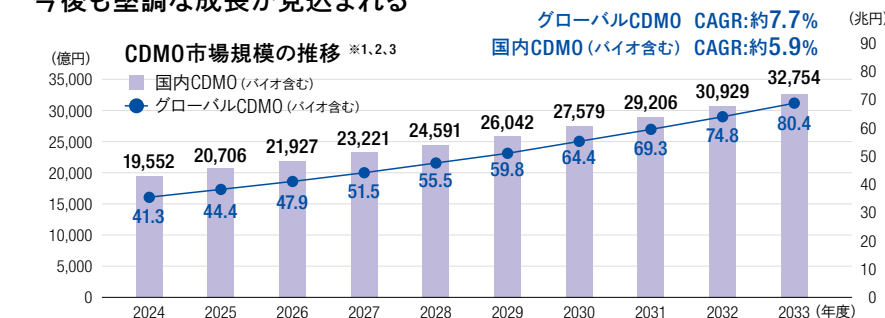
AI/DX事業

医療機関の「治験業務」の効率化を推進



市場環境

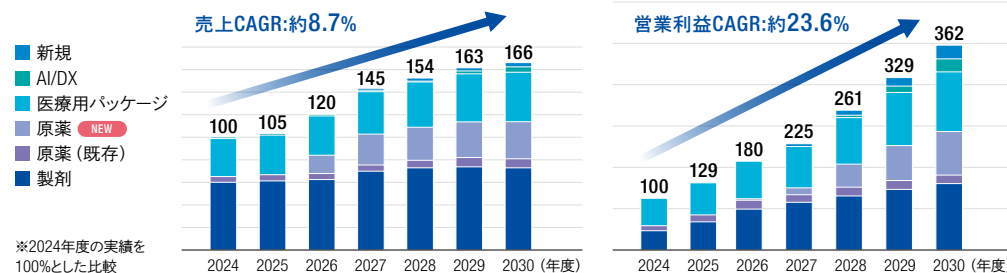
グローバル・国内ともに年平均成長率5%以上で
今後も堅調な成長が見込まれる



※1 CDMO: Contract Development and Manufacturing Organizationは、医薬品の開発および受託製造を行う専門事業者・事業体
※2 国内CDMO市場規模 (出典): (Report Ocean社)「日本受託開発製造業界 (CDMO) 市場規模...2025年から2033年までの機会分析と業界予測」より
※3 グローバルCDMO市場規模 (出典): (The Business Research Company)「Pharmaceutical Contract Development And Manufacturing Organization (CDMO) Global Market Report 2026」より

業績推移と将来展望

新規モダリティ分野、創薬支援領域、AI/DX活用などの新事業開発や
M&Aを組み合わせ、継続的な成長を実現

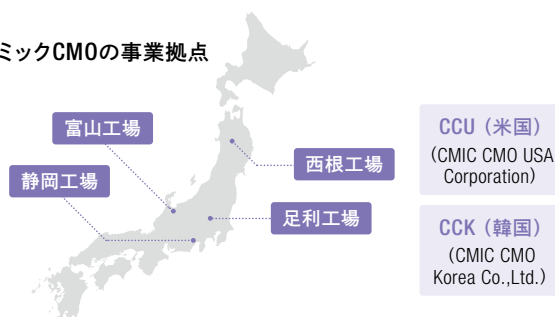


原薬・製剤・パッケージ・AI/DXの連携で事業成長を加速

① 製剤事業

国内有数のCDMOであるシミックCMOの製造能力と、DNPの持つAI/DX活用力、生産技術の革新力を掛け合わせ、付加価値の高い製剤事業を推進する。

シミックCMOの事業拠点



DNPは2023年4月にシミックCMOの株式50.1%を取得。シミックCMOは生産拠点を国内4カ所・海外2カ所（米国、韓国）に置き、医薬品製造受託事業を展開。

② 原薬事業

DNPは、医薬品の有効成分である「原薬」を製薬会社へ供給する医薬品原薬の製造販売事業を展開。高度な製造技術と厳格な品質管理体制のもと、製薬企業への安定的な原薬供給を実現する。

● 協和ファーマケミカル NEW

2026年10月に有機合成で強みを持つ協和ファーマケミカル株式を100%取得して子会社化し、社名を「DNPファーマケミカル」に変更予定。治験薬および先発薬向け原薬事業を拡大する。

※2026年7月15日付で、協和ファーマケミカル株式会社の株式取得に向けた株式譲渡契約を締結

● DNPファインケミカル宇都宮

2007年にコニカミノルタの原薬事業を譲受し、ジェネリック医薬品向け原薬の合成ルートの探索から原薬製造まで一貫して行っている。

③ 医療（医薬品・医療機器）パッケージ事業

機能性材料を薄く均一にコーティングする精密塗工技術、複数のフィルム等をラミネートする（貼り合わせる）加工技術など、食品・日用品領域で培った技術と価値を掛け合わせ、医薬品・医療機器のパッケージを開発・製造。医療現場の厳格なニーズを的確にとらえ、安全性や利便性の向上に貢献していく。



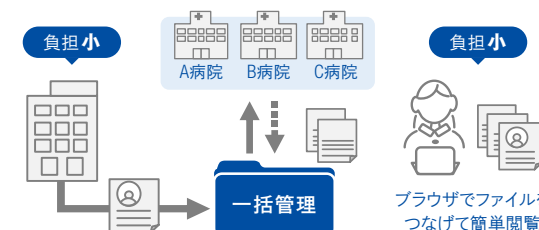
④ 治験業務AI/DX支援

医療機関を中心に、治験業務の効率化・DX化を支援するシステム・サービスを提供。例えば、治験文書のデジタル管理によって、文書の管理・配布確認の負担低減などにつなげていく。

TO BE

製薬会社の文書配布を一括効率化、
審査委員会は、ブラウザで簡単閲覧

製薬会社（依頼者） 病院（実施者） IRB（審査委員会）



協和ファーマケミカルの高度な有機合成技術、シミックCMOの製剤技術、
DNPのパッケージ技術を連動し、ワンストップCDMOの実現をめざします。



CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization）は、医薬品の開発および受託製造を行う専門事業体

世界トップレベルのシェアと技術力等を強みとし、最先端製品・新製品の開発強化、生産能力の増強などを推進

2023-2025年度 中期経営計画レビュー

2026-2028年度 中期経営計画

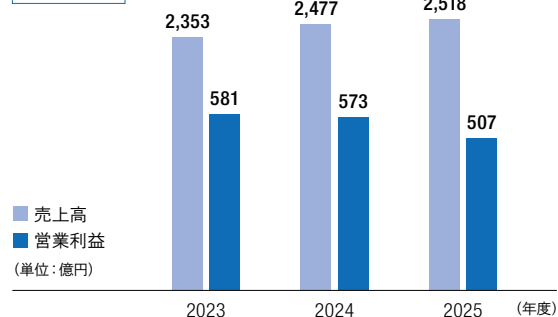
振り返り

- デジタルインターフェース関連は2025年度第4四半期に半導体メモリ不足の影響を受けるも、市場成長に伴い着実に成長。
- 分野全体で中長期的な成長を見据えて積極的に成長投資を実施し、事業基盤を強化。

2025年度売上概要

- 光学フィルム**：液晶テレビ用パネルサイズの大型化に伴う出荷面積の拡大と、広幅対応の新生産ラインが寄与し、前年を上回った。
- 有機ELディスプレイ製造用メタルマスク**：第8世代（G8）サイズのガラス基板向け大型メタルマスクの寄与があったものの、半導体メモリ不足の影響を受け、前年から微減。
- 半導体関連**：市況が堅調に推移したことで前年を上回るとともに、引き続き最先端領域への事業展開に注力。

業績推移



ポートフォリオの変革の考え方

事業拡大の可能性を確認し、ガラスコア基板をはじめとする半導体プロセスの「後工程」に関連する事業を新たに成長ポテンシャル事業として設定した。

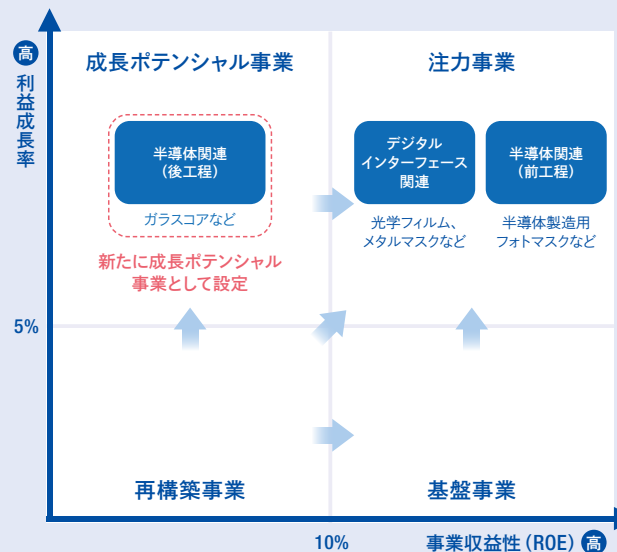
注力事業への積極投資

- デジタルインターフェース関連**：
 - ・**有機ELディスプレイ製造用メタルマスク**：有機ELディスプレイの大型化に伴い、G8サイズの大型メタルマスクを中心に事業を拡大していく。
 - ・**ディスプレイ用光学フィルム**：ディスプレイパネルの大型化に対応した広幅対応の新生産ラインの活用などによって事業を拡大。
- 半導体関連(前工程)**：半導体需要の伸長が続く中、フォトリソの市場成長を先取りした最適な開発・生産体制を構築し、継続的に事業を成長させていく。EUV用マスクや、ナノインプリントなどの最先端領域への事業展開を加速させる。

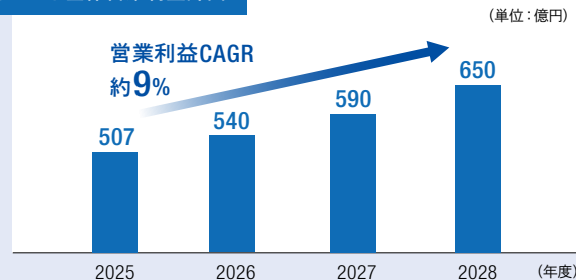
新たな注力事業の育成

- 半導体関連(後工程)**：次世代半導体パッケージ向けTGV（ガラス貫通電極）ガラスコア基板の技術を中心に、半導体プロセスの後工程を成長ポテンシャル事業と位置づけ、成長を加速させていく。

ポートフォリオの変革



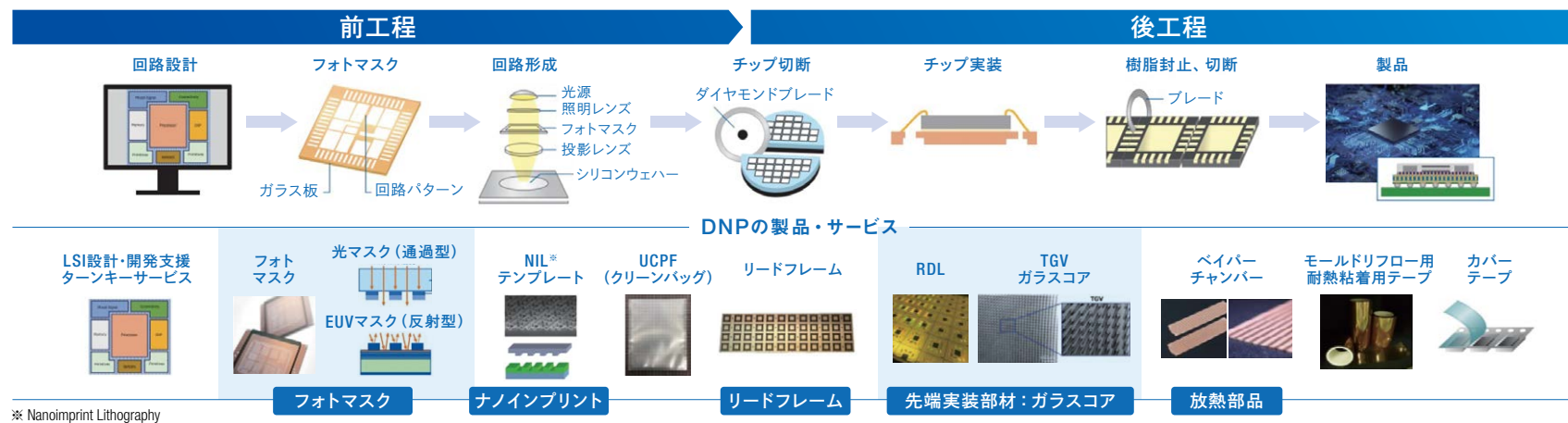
セグメント全体営業利益計画



継続的な技術開発と強固なパートナーシップにより競争力を生み出す

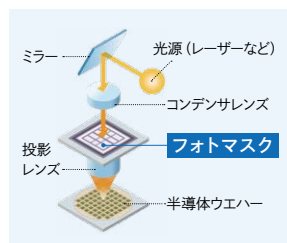
DNPは、生成AIやメタバース、データセンターの広がりなどで世界的に需要が高まる半導体製品に対し、その製造プロセス全体で多様な製品・サービスを提供。独自に培った微細加工や精密塗工などの技術を常に最先端に磨いて掛け合わせるとともに、DNPと異なる強みを持つパートナーとの積極的なM&Aや業務提携を推進し、新しい価値の創出を加速させていく。

半導体製造プロセスとDNPの半導体関連製品・サービス (全体イメージ)



●半導体製造用フォトマスク

微細な回路パターンを光を使って基板に転写する際に、写真のネガのような役割を果たすガラス板がフォトマスク。DNPは、印刷プロセスで培った微細加工技術を独自に進化させて、多様なフォトマスクを開発・提供している。1959年に成功したトランジスタ用蒸着マスクの開発に始まり、現在はテクノロジーノード2ナノメートル(nm:10億分の1m)レベルのパターンの解像に成功し、エレクトロニクス製品の進化に貢献している。



●ナノインプリント用テンプレート

ナノインプリントリソグラフィは、樹脂を塗布した基板にテンプレート(版)を圧着させることで、テンプレート上に形成した回路パターンを樹脂上に超微細な凹凸として転写する技術。最先端の半導体製品に対応するとともに、製造プロセスの消費電力を大幅に低減する手法として注目されている。

●ガラスコア

高機能デバイス向けパッケージ用の先端実装基板では有機材を用いたコア基板が採用されている。今後の実装基板の微細配線化、大型化に伴う課題(平坦性や反り)の解決のため、有機材からガラス材へ変更したコア基板が注目されている。

●リードフレーム

DNPは、半導体チップを固定・接続する基材=リードフレームの生産を1964年に開始。半導体製品の高性能・多機能化や小型・軽量化などのニーズを先取りし、多様な製品を開発・提供している。



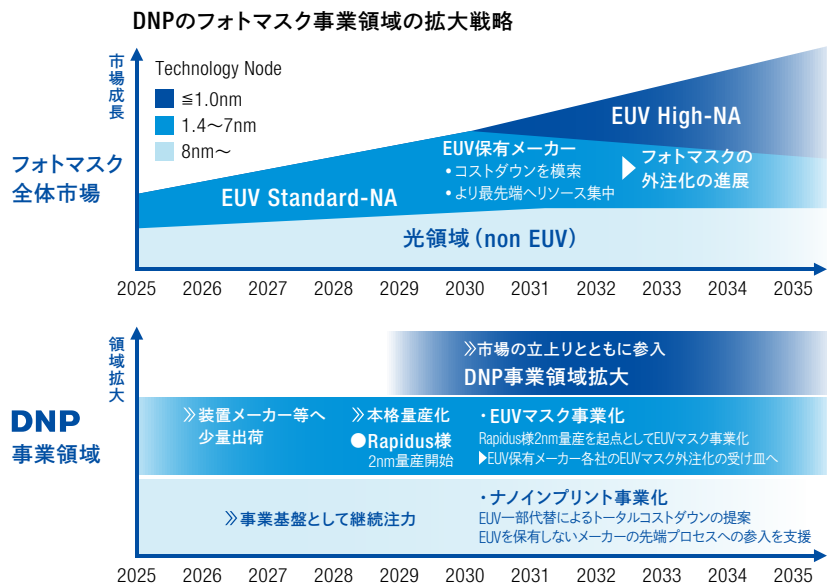
成長戦略

最先端～ボリュームゾーンをカバーし、
半導体市場の成長を確実に捉える
事業ポートフォリオを構築

先端のロジック用やメモリ用の半導体におけるデバイスメーカーのフォトマスク外注化の流れをDNPの成長機会と捉えている。EUV（極端紫外線）用をはじめとする最先端マスクで、確実な供給能力を備えたパートナーとしての地位を確立する。ナノインプリント（NIL）向けマスクの唯一のサプライヤーとしても市場参入をさらに進め、最先端領域での競争優位性を強化する。また、安定した需要が見込まれる先端領域～ボリュームゾーン対応も継続することで、半導体市場を全方位でカバーし、持続的な事業成長を実現する。



「半導体・オブ・ザ・イヤー2026」半導体用電子材料部門でグランプリを受賞



最先端領域（EUV領域）

High-NA

- ・対応準備 ▶ 評価用マスク提供中

Standard-NA

- ・Rapidus様のNEDO事業*再委託を通じた経験から製造基盤を構築
- ・検査／品質保証体制の先行確立
- ・2026年 Rapidus様へ出資

※NEDO事業：ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業

ナノインプリント

- ・EUV補充／代替技術としての立ち位置を確立
▶EUVレベルの微細配線形成キャッチアップ
- ▶EUV・ナノインプリント量産化に向けて先行投資促進

先端領域～ボリュームゾーン

先端領域（8～14nm）：既存事業における高付加価値領域

▶ 当面の収益基盤として投資継続

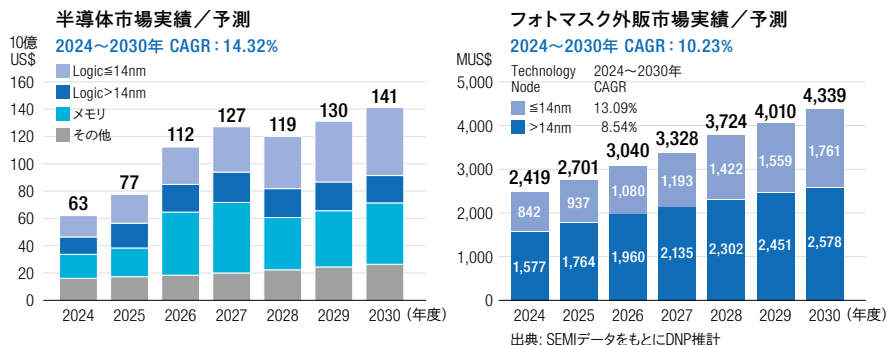
ボリュームゾーン（22～65nm）：光領域の60%を占める規模

▶ 重要な基盤事業領域として投資継続

市場環境

AI半導体需要の成長・外販フォトマスク市場の拡大

AI需要の拡大などを背景とした半導体市場の成長に牽引され、DNPが主に製品を供給するフォトマスク外販市場も最先端～先端領域、ボリュームゾーンとも確実に拡大



業績推移と将来展望

最先端領域のブレイクスルーを確かなチャンスとし、
市場力バレッジ拡大に向けた集中投資を実施

最先端領域

売上：2028年度+100億円 ▶ +240億円
(2024年度比) ※最先端領域での売上増加分

成長へのステップ

技術力実証

2nm世代EUVマスク解像成功により最先端技術力を実証

品質・製造基盤確立

製造基盤の獲得
検査／品質保証体制の先行確立

量産・事業拡大

量産化に向けて先行投資
外注化需要の獲得

●EUV用マスク事業

2027年本格量産開始

●ナノインプリント事業

2027年量産開始

先端領域～ボリュームゾーン

●光マスク事業

生産能力拡充のための投資継続

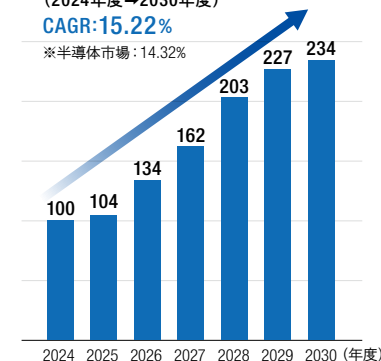


売上計画（2024年度を100とする）

(2024年度→2030年度)

CAGR:15.22%

※半導体市場：14.32%



成長戦略

有力パッケージ基板メーカーとの 戦略的協働による 先端パッケージ関連事業の拡大

半導体パッケージ基板のコア材として、現状の有機材ベースに対し、回路パターンの微細化とチップの大型化に合わせ、より平坦性が高く、反りの少ないガラスが注目されている。その際、ガラスの表裏を接続する微細で高密度な貫通電極の形成が必要となる。DNPは、液晶ディスプレイ用カラーフィルターで培った薄型・大型ガラスのハンドリング技術と微細加工技術を融合し、パッケージ基板の進化に対応するガラスコアを実現。新たな成長を牽引する事業として開発を加速させていく。



2025年12月「TGV（ガラス貫通電極）ガラスコア基板」のパイロットライン
を久喜工場（埼玉県）に新設

DNP

優位性

- 高アスペクト比TGVボイドレスめっき技術
- 精密パターンニング技術
- 半導体設計技術（協調設計）
- ケミカル材とプロセスの組み合わせ（多面的ポートフォリオの掛け合わせ）
- ガラスコアに特化した開発形態（多くの接点での情報収集力）

有力パッケージ基板メーカー

- 半導体後工程での高いプレゼンス
- 顧客基盤
- 高い開発／量産技術

大きなシナジーを生み、
持続的に価値創出

中期

次世代先端パッケージ 関連事業参入

DNP開発先端パッケージ技術の事業化加速



FC-BGA基板有力メーカーとのパートナーシップにより製品開発／上市を加速

- ▶ ガラスコア：ビルドアップ工程との高度な擦り合わせ → 高い製品の完成度
- ▶ RDL Interposer：微細配線／信頼性保証技術 × パッケージ基板技術 = 2.XDパッケージへの展開

中～長期

光電融合 関連事業参入

光電融合関連の新製品開発～事業化

Co-Packaged Optics



AIデータセンターの課題解決に資する光電融合に関連する新製品開発の加速

- ▶ DNP保有技術（Imprint, photolithography, etc）と既存開発技術とのシナジー検討

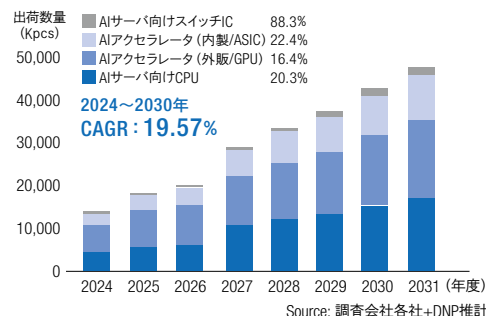
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

市場環境

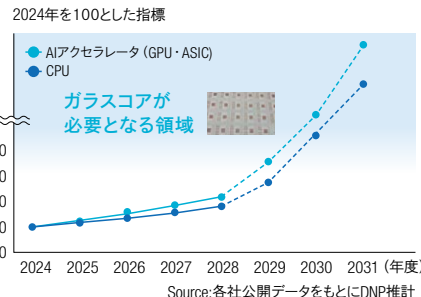
AI半導体需要・ガラスコア市場の拡大

AI向けを中心に高機能半導体の需要が拡大し、半導体パッケージが大型化する中、新たな“ガラスコア市場”誕生への期待を背景に、DNPの事業を拡大していく。

AIサーバ向け高機能半導体市場実績／予測（数量ベース）



AIサーバ向け高機能半導体 パッケージサイズの推移予測



業績推移と将来展望

市場の立ち上がりを見据え、量産体制の構築を段階的に推進

2026-2028年度の設備投資計画：300億円

半導体メーカーの動向

- 量産に向けてマーケットにおける評価を実施
- 採用判断：2027年末～2028年前半
- 量産開始：2030年度～順次開始

DNPの事業方針

- DNPの技術優位性が発揮できる高付加価値領域
＝高アスペクト・高品質をターゲットに量産に向けて段階的に準備
▶ 2025年末に久喜工場（埼玉県）でパイロットライン完成、稼働開始
- パッケージ基板提携メーカーとの協働を軸とした開発／事業化を進める
▶ 2025年度に協働スタート
- 2030年度の量産化を想定した投資を計画
▶ 半導体／基板メーカーの動きに合わせた量産ラインの敷設（久喜工場）に向けた投資を2026年度中に判断

売上計画（2024年度を100とする）

